

短觀大型製造業持續改善、半導體設備銷售創新高

2024 年 7 月 2 日

➤ 日銀短觀顯示企業信心持續改善

日銀公布第二季度短觀調查報告，日本大型製造業信心指數自上季的 11 攀升至 13，表現優於經濟學家預期的持平不動；大型非製造業信心指數則自 34 小幅降低到 33，符合預期，仍處於 30 多年來的高檔區。此外，大型製造業展望指數更自 10 攀升至 14，大幅優於預期的 11，顯示製造業持續處於改善的趨勢上，這將為央行本月稍晚可能的升息動作提供支持。

➤ 半導體設備銷售亮眼，相關公司獲利可期

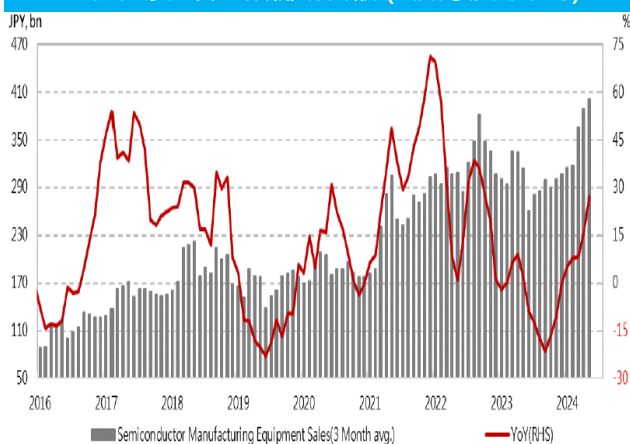
日本 5 月半導體製造設備銷售額 (3 個月平均值) 達 4006.5 億日圓，為首次突破 4000 億日圓大關，更創下歷史新高紀錄；年增幅達 27%，不僅為連續 5 個月正成長，更為 2022 年 10 月以來最大增幅，顯示在 AI 晶片等需求強勁下，廠商對半導體設備投資明顯攀升。

展望後市，根據日本半導體製造裝置協會(SEAJ) 的預估，受惠於記憶體需求將在下半年度大幅復甦，2024 財年半導體設備銷售額將達 4 兆日圓之上，將為有統計來最高。此外，半導體設備巨擘東京威力科創先前表示，預計 2024 年下半年，對 HBM、DDR5 等需求的增加，將帶動對記憶體設備需求，且預計到 2025 年對 AI 伺服器需求將持續成長，而中國對半導體設備的強勁需求亦將可望延續至 2025 年。整體而言，半導體設備銷售預期將延續亮麗表現，亦將對相關公司獲利帶來貢獻。

➤ 日圓過度弱勢，將刺激 7 月日本央行有所動作

上週五日圓持續弱勢，日圓一度貶破 161 兌一美元，為 1986 年以來首次跌破該價位。日本財務省最高外匯事務官員神田真人上週表示，如有必要當局隨時準備一天 24 小時全天候干預匯市，但匯市卻毫不買帳，週五媒體報導財務省已任命三村淳接替神田為最高外匯事務官員。上述消息顯示，日本官方對於日圓貶值已越來越沒有耐性，加上日本經濟的好轉、通膨持續處於 2% 以上，均將支持日本央行於 7 月底例會再度升息 0.1%，並將大幅縮減購債規模，這將有利於未來日圓的逐步轉強。

日本半導體製造設備銷售額 (3 個月移動平均)



資料來源：SEAJ, 元大投顧

日銀短觀調查



資料來源：Bloomberg, 2024/7/1

本報告係無償提供，僅供參考之用。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信之可靠來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行及本行之任何董事或受僱人，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資風險，自行承擔一切投資風險並自負盈虧，本行不負任何法律責任。本報告受中華民國著作權法保護為元大銀行所有，非經本行同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散布。本報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。